证券代码: 873928 证券简称: 瑞能半导 主办券商: 西南证券

## 瑞能半导体科技股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险 提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

## 一、公司公开发行股票并在北交所上市进展

根据瑞能半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")前期制定的北京证券交易 所发行上市计划,公司股票于2023年1月20日起在全国股转系统挂牌公开转让,并 预计在公司完成挂牌后 18 个月内向北京证券交易所提交上市申请文件。

由于公司资本市场运作安排变化,公司于挂牌后的 18 个月内不会向北交所提交上 市申请文件。公司后续将根据《证券法》等相关法律、法规和上市规则,结合公司战 略规划情况,对公司发行上市计划进行调整优化,并及时履行相关信息披露义务。

## 二、风险提示

基于上述情况,公司存在申报上市进度不确定性的风险。公司将根据相关事项进 展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务、敬请广大投资者关 注,并注意投资风险。

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日